

【名稱】：SOT89-5 & QFN5 & QFN6 & DFN6 轉 DIP

【型號】：MP0506QS1

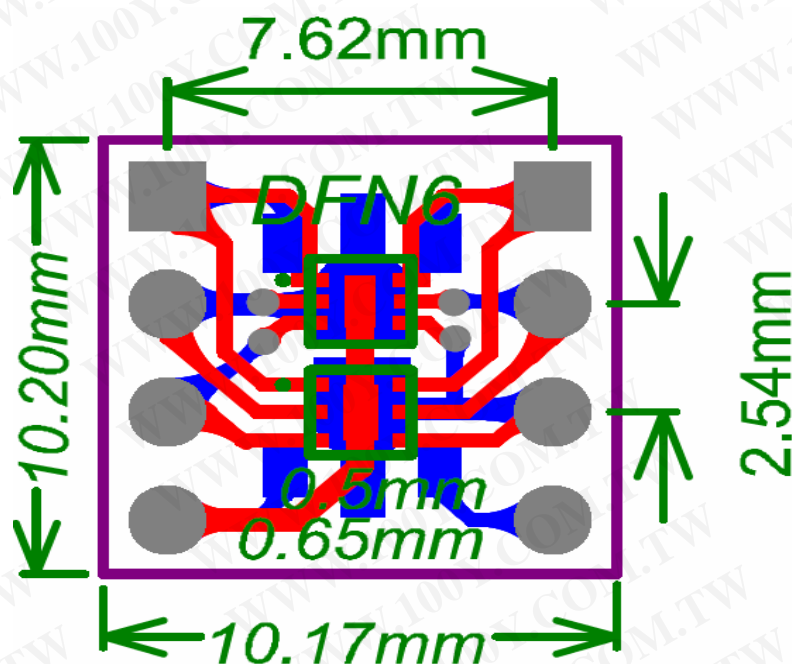
【品牌】：SmartCool

【描述】：板材：FR4 板材，板色：黑色，板層：2層，板厚：1.6mm，銅厚：1OZ，焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面特殊鍍金）

尺寸：10.2*10.17*1.6mm

用途：本轉接板適用於以下晶片封裝【①、Pitch（腳與腳間距）=1.5mm 的 SOT89-5、QFN5；
②、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 DFN6 QFN6；③、Pitch（腳與腳間距）=0.65mm 的 DFN6 QFN6】

特點：可支援多個貼片封裝晶片轉外掛程式（但每個板一次只能焊接一個晶片轉外掛程式）



DFN6 SOT89-5 轉 DIP



兼容以下封裝：

DFN6-0.65mm QFN6

DFN6-0.5mm QFN6

SOT89-5 SOT89-3 QFN5